

超音波探傷技術セミナーのご案内【10月17日（金）川崎】

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ディービー株式会社は世界最先端の超音波探傷技術をご紹介することを目的に、川崎にて技術セミナーを開催致します。本セミナーでは、世界各国の大手重電機器メーカー、航空機・航空機部品メーカー、検査・検査コンサルティング会社で実機適用がされている最先端の超音波探傷についてのハードウェア技術及びソフトウェア技術をご紹介致します。また、実機によるデモ実演、質疑応答を通じて、技術的な理解と交流を深めて頂きます。

ご多忙とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

開催概要

■ 日時・会場

【川崎開催】2025年10月17日(金)13:00～15:30 (12:30 受付開始)

定員 30名 参加費：無料（事前登録制）

ステーションコンファレンス川崎 Room F

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1-5

最寄駅：JR 川崎駅 徒歩 5分

【主催】ディービー株式会社 TPAC JAPAN

【共催】Advanced OEM Solutions（アメリカ）

The Phased Array Company（アメリカ）



■ プログラム

13:00～13:10 ご挨拶

13:10～14:10 第一部「TPAC 社における高度超音波探傷装置の開発と適用事例」

(質疑応答 13:55～14:10)

第一部では、TPAC 社ハードウェア開発マネージャーの Thomas PARTIOT より、同社の取り組みと最新の装置開発についてご紹介いたします。TPAC 社は、超音波探傷に対するグローバルな需要に応えるべく、高度なフェーズドアレイおよびマルチチャンネル超音波探傷装置の開発・製品化を進めており、その技術は世界各国の先端企業で採用されています。本セミナーでは、TPAC 社の会社概要やグローバルでの展開状況に加え、最先端装置の特長・応用事例の紹介いたします。

The Phased Array Company

ハードウェア開発マネージャー トマ・パルチオ (Thomas PARTIOT)

ディービー株式会社

技術営業マネージャー 春田 石男

14:20～15:20 第二部「超音波探傷イメージング技術セミナー ― 基礎から最先端の応用技術 ―」

(質疑応答 15:05～15:20)

第二部では、TPAC 社の Dr. Ewen CARCREFF を講師に迎え、超音波探傷イメージング技術に関するセミナーを開催いたします。本セミナーでは、フェーズドアレイ UT および FMC/TFM の基礎から、近年高い S/N 比の実現手法として注目を集めている コヒーレンスイメージングまで、幅広い内容をわかりやすく解説いたします。

最新の技術動向を理解し、実務への応用のヒントを得られる貴重な機会となっております。ぜひご参加ください。

The Phased Array Company

超音波イメージング研究開発責任者 エウエン・カルクレフ (Ewen CARCREFF, Ph.D.)

ディービー株式会社

技術統括チーフ 赤松 亮

※発表言語英語及び日本語となります。（同時通訳有）

※講演者及び講演内容は変更になる場合がございます。

※本セミナーは事前登録制となっております。お申込みは、電子メールにてお願い致します。info@db-kk.com

※座席については、座席間に十分なスペースを空けております。（机あり）

※セミナーの内容に関しては 当日若干の変更の可能性もございますのでご了承ください。

お問い合わせ先

ディービー株式会社 e-Mail: info@db-kk.com

本社 : 〒542 0075 大阪市中央区難波千日前 5-19 河原センタービル 4F

東京 : 〒210 0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町 6-1 高木ビル 4F

TEL 06-6809-3762 FAX06-6809-3763